目　录

一、模拟审计报告……………………………………………………第 1—3 页

二、模拟财务报表…………………………………………………… 第 4—6 页

（一）模拟资产负债表……………………………………………… 第 4—5 页

（二）模拟利润表…………………………………………………… 第 6 页

三、模拟财务报表附注………………………………………………第 7—64 页

四、附件……………………………………………………………… 第 65—69 页

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：浙26LAYF25AU

地址：杭州市钱江路1366号
Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

模 拟 审 计 报 告

天健审〔2026〕18230号

晶艺半导体有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了晶艺半导体有限公司（以下简称晶艺半导体公司）芯片自研业务、芯片定制化量产业务两个板块的模拟财务报表，包括2024年12月31日、2025年12月31日、2026年6月30日的模拟资产负债表，2024年度、2025年度、2026年1—6月的模拟利润表，以及相关模拟财务报表附注。

我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照“模拟财务报表附注二模拟财务报表的编制基础”编制，反映了晶艺半导体公司2024年12月31日、2025年12月31日、2026年6月30日的模拟财务状况，以及2024年度、2025年度、2026年1—6月的模拟经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对模拟财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于晶艺半导体公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项——编制基础

我们提醒模拟财务报表使用者关注模拟财务报表附注二对编制基础的说明。

晶艺半导体公司编制模拟财务报表是为了模拟财务报表附注二所述向相关监管部门申报和有关披露相关信息之目的而编制，不适用其他用途。因此，模拟财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他事项——对审计报告的分发和使用的限制

本报告仅供苏州锴威特半导体股份有限公司与晶艺半导体公司的重大资产重组交易目的参考之用，不得用作任何其他目的。我们明确表示不会就本报告的内容向任何以其他目的使用本报告的使用方负有任何义务或承担任何责任。

五、管理层和治理层对模拟财务报表的责任

晶艺半导体公司管理层（以下简称管理层）负责按照“模拟财务报表附注二模拟财务报表的编制基础”编制模拟财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制模拟财务报表时，管理层负责评估晶艺半导体公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

晶艺半导体公司治理层（以下简称治理层）负责监督晶艺半导体公司的财务报告过程。

六、注册会计师对模拟财务报表审计的责任

我们的目标是对模拟财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响模拟财务报表使用者依据模拟财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的模拟财务报表重大错报风险，设计

和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晶艺半导体公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意模拟财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晶艺半导体公司不能持续经营。

（五）评价模拟财务报表的总体列报、结构和内容，并评价模拟财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就晶艺半导体公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对模拟财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：

二〇二六年十一月十一日

模 拟 资 产 负 债 表（资产）

会企01表

编制单位：晶艺半导体有限公司　　单位：人民币元

资　　产	注释号	2026年6月30日			2025年12月31日			2024年12月31日		
		芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
流动资产：										
货币资金	1	131,042,197.61	70,809,616.33	201,851,813.94	216,582,988.98	158,842,542.27	375,425,531.25	101,310,389.36	95,027,574.52	196,337,963.88
交易性金融资产	2	45,594,045.24	24,637,078.05	70,231,123.29	75,171,263.31	55,130,805.18	130,302,068.49	77,576,552.06	72,765,603.09	150,342,155.15
衍生金融资产										
应收票据										
应收账款	3	67,890,223.64	41,858,664.76	109,748,888.40	22,583,167.30	30,952,662.32	53,535,829.62	13,204,367.30	30,956,846.71	44,161,214.01
应收款项融资										
预付款项	4	13,922,105.82	2,288,486.71	16,210,592.53	3,749,148.67	2,804,911.82	6,554,060.49	4,477,266.09	2,346,713.04	6,823,979.13
其他应收款	5	3,015,069.63	528,198.68	3,543,268.31	2,828,800.82	706,062.74	3,534,863.56	2,710,611.88	287,825.73	2,998,437.61
存货	6	117,429,427.04		117,429,427.04	109,190,208.18		109,190,208.18	113,435,856.61		113,435,856.61
其中：数据资源										
合同资产										
持有待售资产										
一年内到期的非流动资产	7	21,385,026.66	11,555,556.61	32,940,583.27	18,694,516.58	13,710,608.37	32,405,124.95			
其他流动资产	8	3,582,429.57	101,087,745.82	104,670,175.39		51,307,712.78	51,307,712.78	18,138.26	60,705,696.80	60,723,835.06
流动资产合计		403,860,525.21	252,765,346.96	656,625,872.17	448,800,093.84	313,455,305.48	762,255,399.32	312,733,181.56	262,090,259.89	574,823,441.45
非流动资产：										
债权投资										
其他债权投资										
长期应收款										
长期股权投资										
其他权益工具投资										
其他非流动金融资产										
投资性房地产										
固定资产	9	6,256,304.79	3,878,350.77	10,134,655.56	7,252,582.42	3,836,192.26	11,088,774.68	9,008,422.22	4,733,573.58	13,741,995.80
在建工程	10				97,194.05		97,194.05			
生产性生物资产										
油气资产										
使用权资产	11	6,546,677.06	4,357,182.14	10,903,859.20	384,476.51	392,871.87	777,348.38	1,488,416.11	1,599,584.11	3,088,000.22
无形资产	12	952,717.45	162,896.87	1,115,614.32	1,111,838.69	277,051.16	1,388,889.85	1,484,208.53	406,247.30	1,890,455.83
其中：数据资源										
开发支出										
其中：数据资源										
商誉										
长期待摊费用	13	345,023.63	68,233.72	413,257.35	447,555.96	61,821.29	509,377.24	665,593.45	62,041.20	727,634.65
递延所得税资产	14	5,667,745.73	1,783,942.54	7,451,688.27	3,513,164.35	1,642,958.30	5,156,122.65	2,289,344.89	1,615,812.92	3,905,157.81
其他非流动资产	15	1,526,564.03	502,015.97	2,028,580.00	856,136.78	871,060.39	1,727,197.17	15,706,628.27	16,356,149.04	32,062,777.31
非流动资产合计		21,295,032.69	10,752,622.01	32,047,654.70	13,662,948.75	7,081,955.27	20,744,904.02	30,642,613.47	24,773,408.15	55,416,021.62
资产总计		425,155,557.90	263,517,968.97	688,673,526.87	462,463,042.59	320,537,260.75	783,000,303.34	343,375,795.03	286,863,668.04	630,239,463.07

法定代表人：易坤　　主管会计工作的负责人：苏鹏飞　　会计机构负责人：吴春燕

3-1-2-5

模拟资产负债表（负债和所有者权益）

会企01表

编制单位：晶艺半导体有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益	注释号	2026年6月30日			2025年12月31日			2024年12月31日		
		芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
流动负债：										
短期借款	16	74,974,802.90		74,974,802.90	40,030,222.22		40,030,222.22	41,051,472.22		41,051,472.22
交易性金融负债										
衍生金融负债										
应付票据	17	20,802,028.76	8,790,153.85	29,592,182.61	22,178,322.94	6,664,201.20	28,842,524.14			
应付账款	18	26,888,214.14	44,174,396.30	71,062,610.44	15,206,766.58	19,772,779.55	34,979,546.13	10,697,288.98	15,868,804.40	26,566,093.38
预收款项										
合同负债	19	914,816.24		914,816.24	1,250,560.53		1,250,560.53	753,184.29		753,184.29
应付职工薪酬	20	14,912,644.59	1,644,809.79	16,557,454.38	25,853,304.06	4,327,326.28	30,180,630.34	18,580,068.78	2,984,814.14	21,564,882.92
应交税费	21	78,906.55	3,723,047.10	3,801,953.65	2,026,715.36	5,869,733.37	7,896,448.73	108,342.30	101,623.41	209,965.71
其他应付款	22	378,941.97	308,282.05	687,224.02	119,967,079.23	122,579,987.23	242,547,066.46	319,951.82	561,048.17	880,999.99
持有待售负债										
一年内到期的非流动负债	23	10,995,236.29	823,907.97	11,819,144.26	10,359,594.02	359,015.90	10,718,609.92	1,138,847.10	1,223,906.21	2,362,753.31
其他流动负债	24	105,076.27		105,076.27	148,279.93		148,279.93	97,913.97		97,913.97
流动负债合计		150,050,667.71	59,464,597.06	209,515,264.77	237,020,844.87	159,573,043.53	396,593,888.40	72,747,069.46	20,740,196.33	93,487,265.79
非流动负债：										
长期借款										
应付债券										
其中：优先股										
永续债										
租赁负债	25	5,161,391.98	3,435,196.93	8,596,588.91				277,729.82	298,473.12	576,202.94
长期应付款										
长期应付职工薪酬										
预计负债										
递延收益	26	1,481,976.75		1,481,976.75	3,333,444.71		3,333,444.71	220,111.39		220,111.39
递延所得税负债										
其他非流动负债										
非流动负债合计		6,643,368.73	3,435,196.93	10,078,565.66	3,333,444.71		3,333,444.71	497,841.21	298,473.12	796,314.33
负债合计		156,694,036.44	62,899,793.99	219,593,830.43	240,354,289.58	159,573,043.53	399,927,333.11	73,244,910.67	21,038,669.45	94,283,580.12
所有者权益：										
归属于母公司所有者权益合计		268,461,521.46	200,618,174.98	469,079,696.44	222,108,753.01	160,964,217.22	383,072,970.23	270,130,884.36	265,824,998.59	535,955,882.95
少数股东权益										
所有者权益合计		268,461,521.46	200,618,174.98	469,079,696.44	222,108,753.01	160,964,217.22	383,072,970.23	270,130,884.36	265,824,998.59	535,955,882.95
负债和所有者权益总计		425,155,557.90	263,517,968.97	688,673,526.87	462,463,042.59	320,537,260.75	783,000,303.34	343,375,795.03	286,863,668.04	630,239,463.07

法定代表人：易坤　　主管会计工作的负责人：苏鹏飞　　会计机构负责人：吴春燕

模拟利润表

编制单位：晶艺半导体有限公司　　会企02表　　单位：人民币元

项　目	注释号	2026年1-6月			2025年度			2024年度		
		芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一、营业收入	1	180,104,701.96	97,304,691.35	277,409,393.31	201,754,980.52	147,961,792.24	349,716,772.76	131,540,344.47	123,397,822.03	254,938,166.50
减：营业成本	1	122,234,608.68		122,234,608.68	131,044,331.76		131,044,331.76	86,998,567.30		86,998,567.30
税金及附加	2	715,619.39	386,690.20	1,102,309.59	1,154,870.78	846,985.31	2,001,856.09	311,972.98	292,625.82	604,598.80
销售费用	3	17,233,934.64	780,003.52	18,013,938.16	17,053,267.73	2,496,506.12	19,549,773.85	15,459,435.59	2,575,370.28	18,034,805.87
管理费用	4	125,757,012.10	46,197,643.74	171,954,655.84	77,763,912.39	44,112,740.24	121,876,652.63	18,765,754.19	4,695,649.82	23,461,404.01
研发费用	5	31,165,715.60	3,526,527.23	34,692,242.83	78,329,290.83	6,193,941.28	84,523,232.11	82,969,449.42	5,472,241.91	88,441,691.33
财务费用	6	390,741.08	-271,819.80	118,921.28	-197,677.03	-1,119,856.46	-1,317,533.49	-827,888.12	-1,717,436.72	-2,545,324.84
其中：利息费用		975,251.52	44,024.71	1,019,276.23	1,370,134.08	29,980.40	1,400,114.48	1,080,538.52	72,637.88	1,153,176.40
利息收入		882,743.49	476,996.94	1,359,740.43	1,951,197.39	1,431,013.38	3,382,210.77	1,721,648.82	1,614,879.90	3,336,528.72
加：其他收益	7	3,546,735.88	867,742.75	4,414,478.63	9,206,662.32	3,485,155.34	12,691,818.26	12,852,491.78	2,906,034.92	15,758,526.70
投资收益（损失以“-”号填列）	8				33,624.02	24,659.94	58,283.96	-123,793.35	-116,031.82	-239,735.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益										
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益										
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）										
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	351,164.17	189,754.15	540,918.32	1,795,907.56	1,315,656.59	3,109,564.15	2,182,628.28	2,047,271.48	4,229,899.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-2,391,385.49	-570,738.56	-2,965,124.05	-499,841.56	-25,818.79	-525,660.35	-432,404.56	-955,824.31	-1,388,228.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-3,810,606.53	140,332.45	-3,670,274.08	-20,998,143.91	-1,317,310.50	-22,315,454.41	-5,509,443.92	-4,661,216.85	-10,170,660.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12				-12,612.45	-12,887.85	-25,500.30	62,735.30	67,420.92	130,156.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-119,700,021.50	47,312,737.25	-72,387,284.25	-113,869,419.36	98,900,930.48	-14,968,488.88	-63,104,643.36	111,367,025.26	48,262,381.90
加：营业外收入	13				0.18		0.18	32,336.35		32,336.35
减：营业外支出	14	8,985.87		8,985.87	12,633.16		12,633.16	1,303.76		1,303.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-119,709,007.37	47,312,737.25	-72,396,270.12	-113,882,052.34	98,900,930.48	-14,981,121.86	-63,073,610.77	111,367,025.26	48,293,414.49
减：所得税费用	15	-2,154,581.38	10,542,113.13	8,387,531.75	-1,223,819.46	6,085,604.14	4,861,784.68	-643,320.21	-321,172.30	-964,492.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-117,554,425.99	36,770,624.12	-80,783,801.87	-112,658,232.88	92,815,326.34	-19,842,906.54	-62,430,290.56	111,688,197.56	49,257,907.00
（一）按经营持续性分类：										
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-117,554,425.99	36,770,624.12	-80,783,801.87	-112,658,232.88	92,815,326.34	-19,842,906.54	-62,430,290.56	111,688,197.56	49,257,907.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）										
（二）按所有权归属分类：										
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-117,554,425.99	36,770,624.12	-80,783,801.87	-112,658,232.88	92,815,326.34	-19,842,906.54	-62,430,290.56	111,688,197.56	49,257,907.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）						0.00				
五、其他综合收益的税后净额		-983,461.49	-531,420.65	-1,514,882.14	-638,080.93	-467,970.25	-1,106,051.18	363,441.41	340,902.40	704,343.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-983,461.49	-531,420.65	-1,514,882.14	-638,080.93	-467,970.25	-1,106,051.18	363,441.41	340,902.40	704,343.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益										
1.重新计量设定受益计划变动额										
2.权益法下不能转损益的其他综合收益										
3.其他权益工具投资公允价值变动										
4.企业自身信用风险公允价值变动										
5.其他										
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-983,461.49	-531,420.65	-1,514,882.14	-638,080.93	-467,970.25	-1,106,051.18	363,441.41	340,902.40	704,343.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益										
2.其他债权投资公允价值变动										
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
4.其他债权投资信用减值准备										
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）										
6.外币财务报表折算差额		-983,461.49	-531,420.65	-1,514,882.14	-638,080.93	-467,970.25	-1,106,051.18	363,441.41	340,902.40	704,343.81
7.其他										
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额										
六、综合收益总额		-118,537,887.48	36,239,203.47	-82,298,684.01	-113,296,313.81	92,347,356.09	-20,948,957.72	-62,066,849.15	112,029,099.96	49,962,250.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-118,537,887.48	36,239,203.47	-82,298,684.01	-113,296,313.81	92,347,356.09	-20,948,957.72	-62,066,849.15	112,029,099.96	49,962,250.81
归属于少数股东的综合收益总额						0.00				
七、每股收益：										
（一）基本每股收益										
（二）稀释每股收益										

法定代表人：易坤　　主管会计工作的负责人：苏鹏飞　　会计机构负责人：吴春燕

3-1-2-7

晶艺半导体有限公司

模拟财务报表附注

2024 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

晶艺半导体有限公司（以下简称公司或本公司）系由成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）、上海巨鱼企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳模数半导体有限公司、济南市一方贸易有限责任公司、成都晶格微科技有限公司、凌风、YA XU、谭清共同出资组建，于 2019 年 1 月 2 日在成都高新区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91510100MA64PH581M 的营业执照。截至 2026 年 6 月 30 日，公司注册资本 5,002.7596 万元。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为集成电路及模块的研发、设计和销售。

二、模拟财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司模拟财务报表以持续经营为编制基础，在合并财务报表的基础上按下列具体假设编制。合并财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《审计报告》（天健审〔2026〕18257 号）。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的相关规定以及下述具体假设进行确认和计量，在此基础上编制模拟财务报表。

1. 本公司整体业务由两块独立的业务板块组成，即芯片自研业务板块和芯片定制化量产业务板块。本公司拟对两个业务板块分别进行评估。为此，本公司需依据不同业务板块的业务实质对合并财务报表进行拆分。该拆分是指本公司将两个业务板块独立记录并反映的财务会计资料，按照本公司一贯执行的会计政策，把两个业务板块的会计记录从原财务会计记录中分离出来，从而形成两个独立业务板块的财务报表的调整行为。

2. 假设本公司全体股东参与本次交易，且约定相关协议中关于本公司作为义务人的相关股东特殊权利均已终止并且自始无效。

3. 本模拟财务报表仅供苏州锴威特半导体股份有限公司与本公司的重大资产重组交易目的参考之用，并向相关监管部门申报和有关披露相关信息之目的而编制，不适用其他用途。

（二）编制原则

1. 本公司通过拆分调整编制的芯片自研业务、芯片定制化量产业务两个业务板块的财务报表，需符合企业会计准则以及其他相关法律、法规和规章的要求，会计政策遵循一贯性原则。因此，本公司在通过拆分调整编制两个业务板块的财务报表时，所选用的会计政策与本公司合并财务报表采用的会计政策保持一致。

2. 本公司在拆分调整编制两个业务板块的财务报表时，应以公司既定的业务架构和产品类别为前提，以实际发生的交易或事项为依据，以历史成本计价原则和收入与相关成本、费用配比原则为主要编制基础，按照报告期内各会计期间各业务板块的业务实质进行拆分编制，同时对公司的资产、负债、收入、成本、费用等进行划分，从而确定纳入两个业务板块各自的财务报表。

（三）编制方法

1. 总体方法

本公司在拆分调整编制两个业务板块的财务报表时，与业务板块直接相关的，按业务板块独立核算；无法直接按业务板块独立核算的，按以下方法进行：

(1) 与销售相关的，按照两个业务板块收入比例分摊计算；

(2) 与管理相关的，以及公共部门资产，按照两个业务板块业务量（各年产品销售数量）比例分摊计算；

(3) 与研发相关的，按照两个业务板块研发人员人工投入比例分摊计算，两个业务板块研发人员人工投入计算方式为：

1) 芯片自研业务研发人员人工投入包括芯片自研业务专属研发人员薪酬，以及共用研发人员薪酬*芯片自研业务板块业务量占比确定的薪酬；

2) 芯片定制化量产业务研发人员人工投入包括芯片定制化量产业务专属研发人员薪酬，以及共用研发人员薪酬*芯片定制化量产业务板块业务量占比确定的薪酬。

(4) 货币资金、理财业务，按照两个业务板块收入比例分摊计算。

上述总体原则在本财务报表附注会计期间及未来期间保持不变。

2. 具体方法

(1) 模拟资产负债表项目

除非特殊说明，两个业务板块的资产负债表分别反映与该业务直接相关的资产及负债项

目，包括应收账款、预付账款、存货、应付账款、合同负债等，以及与两个业务板块间接相关的资产和负债，包括固定资产、使用权资产、无形资产等。直接相关的资产和负债可按照不同的业务板块直接核算，间接相关的资产和负债按照以下方法进行拆分，具体如下：

项 目	拆分方法
货币资金	按照两个业务板块营业收入比例拆分
交易性金融资产	交易性金融资产均为流动性较强的短期理财产品，参考货币资金拆分方法进行拆分，即按照两个业务板块营业收入比例拆分
应收账款	按照客户及订单所属业务板块直接拆分
预付账款	按照供应商及订单所属业务板块直接拆分
其他应收款	1）与生产相关的押金保证金按照供应商所属业务板块直接拆分 2）与公共资产相关的押金保证金按照两个业务板块业务量拆分 3）与代垫社保相关的其他应收款按照两个业务板块薪酬比例拆分
存货	按照对应存货所属业务板块直接拆分
一年以内到期的非流动资产	一年以内到期的非流动资产均为大额存单，参考货币资金拆分方法进行拆分，即按照两个业务板块营业收入比例拆分
其他流动资产	1）芯片定制化量产业务存货按照所属业务板块直接拆分 2）待抵扣进项税额按照两个业务板块营业收入比例拆分 3）预缴税金按照所属业务板块直接拆分 4）待摊费用按照两个业务板块业务量比例拆分
固定资产	1）机器设备按照资产所属业务板块直接拆分 2）办公设备和电子设备按照两个业务板块业务量比例拆分
在建工程	在建工程均与芯片自研业务相关，直接拆分至芯片自研业务
使用权资产	使用权资产为公共资产，按照两个业务板块业务量比例拆分
无形资产	无形资产均为软件，用途为研发的软件按照资产所属业务板块直接拆分；用途为管理的软件按照两个业务板块业务量比例拆分
长期待摊费用	1）装修费按照两个业务板块业务量比例拆分 2）其他项目按照资产所属业务板块直接拆分
递延所得税资产、递延所得税负债	1）资产减值准备确认的递延所得税资产拆分方法与对应的应收账款、存货等拆分方法一致 2）可抵扣亏损均由芯片自研业务产生，相应确认的递延所得税资产直接拆分至芯片自研业务 3）租赁负债、使用权资产确认的递延所得税资产和递延所得税负债拆分方法与租赁负债、使用权资产拆分方法一致 4）递延收益均由芯片自研业务产生，相应确认的递延所得税资产直接拆分至芯片自研业务 5）公允价值变动确认的递延所得税负债拆分方法与交易性金融资产拆分方法一致
其他非流动资产	1）预付设备款按照资产所属业务板块直接拆分 2）大额存单参考货币资金拆分方法进行拆分，即按照两个业务板块营业收入比例拆分
短期借款	考虑到芯片自研业务的资金需求，短期借款均划分为芯片自研业务

应付票据	按照供应商及订单所属业务板块直接拆分
应付账款	按照供应商及订单所属业务板块直接拆分
合同负债	按照客户及订单所属业务板块直接拆分
应付职工薪酬	按照销售费用、管理费用、研发费用中职工薪酬总额在两个业务板块中的比例拆分
应交税费	1）应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税按照两个业务板块营业收入比例拆分 2）应交所得税均由芯片定制化量产业务产生，直接拆分至芯片定制化量产业务
其他应付款	先按照供应商所属业务板块拆分；剩余部分与管理相关的其他应付款按照两个业务板块业务量比例拆分，与研发相关的其他应付款按照研发人员人工投入比例拆分
一年以内到期的非流动负债	一年以内到期的非流动负债中的借款与短期借款的拆分方法一致；租赁负债的拆分方法与租赁负债拆分方法一致
其他流动负债	其他流动负债均为待转销项税额，按照客户及订单所属业务板块直接拆分
租赁负债	按照两个业务板块业务量比例拆分
递延收益	递延收益均由芯片自研业务产生，直接拆分至芯片自研业务
净资产	相应板块的资产减相应板块的负债

(2) 模拟利润表项目

除非特殊说明，两个业务板块的利润表分别反应了与该业务直接和间接相关的损益情况。直接相关的损益包括营业收入、营业成本、资产减值损失等，间接相关的损益包括销售费用、管理费用、税金及附加等。直接相关的损益按照不同的业务板块独立核算，间接相关的损益按照以下方法进行拆分，具体如下：

项 目	拆分方法
营业收入	按照产品收入所属业务板块直接拆分
营业成本	产品成本均与芯片自研业务相关，直接拆分至芯片自研业务
税金及附加	按照两个业务板块营业收入比例拆分
销售费用	本公司芯片定制化量产业务中，由于对核心稳定客户主要提供服务，实际无销售人员，因此按照剔除对核心稳定客户收入后的两个业务板块营业收入比例拆分。
管理费用	按照对核心稳定客户业务的实际参与人员划分对应的职工薪酬，剩余部分按照剔除核心稳定客户收入后的两个业务板块营业收入比例拆分
研发费用	1）模具费均与芯片自研业务有关，直接拆分至芯片自研业务 2）其他费用按照研发人员人工投入比例拆分
财务费用	借款利息支出与芯片自研业务有关，直接拆分至芯片自研业务；其他按照两个业务板块营业收入比例拆分
其他收益	1）政府补助均与芯片自研业务相关，直接拆分至芯片自研业务 2）增值税加计递减及重点人群增值税减免按照两个业务板块营业收入比例拆分 3）个税手续费返还拆分方法与应付职工薪酬拆分方法一致
投资收益	投资收益均由交易性金融资产产生，拆分方法与交易性金融资产拆分方法一致

公允价值变动收益	公允价值变动收益均由交易性金融资产产生，拆分方法与交易性金融资产拆分方法一致
信用减值损失	信用减值损失均由应收账款和其他应收款产生，拆分方法与应收账款和其他应收款拆分方法一致
资产减值损失	资产减值损失均由存货和其他流动资产产生，拆分方法与存货和其他流动资产拆分方法一致
资产处置收益	资产处置收益均由处置使用权资产产生，拆分方法与使用权资产拆分方法一致
营业外收入	按照两个业务板块业务所属直接拆分
营业外支出	按照两个业务板块业务所属直接拆分
所得税费用	1）当期所得税费用均与芯片定制化量产业务相关，直接拆分至芯片定制化量产业务 2）递延所得税费用拆分方法与递延所得税资产和递延所得税负债拆分方法一致

（四）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对存货、固定资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循“附注二模拟财务报表的编制基础”的声明

除上述“附注二模拟财务报表的编制基础”中所述的具体编制假设外，本公司所编制的模拟财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司芯片自研业务和芯片定制化量产业务 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 6 月 30 日的模拟财务状况以及 2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月的模拟经营成果。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本模拟财务报表所载财务信息的会计期间为 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港晶艺半导体有限公司（以下简称香港晶艺）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

（五）重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露模拟财务报表遵循重要性原则，本模拟财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的境外经营实体	利润总额超过集团总资产/利润总额的 15%

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（九）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（十一）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关

负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所

有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十二) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

应收账款和其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其

初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2）合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1）个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2）合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类　别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	平均年限法	3-8	0	12.50-33.33
电子设备	平均年限法	3	0	33.33
办公设备	平均年限法	3	0	33.33

（十六）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类　别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
待安装设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

（十七）无形资产

1. 无形资产包括软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项　目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法

3. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料、燃料和动力费用；2）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，

不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件的摊销费用。

(5) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括咨询费、高新科技研发保险费，知识产权的申请费、注册费，差旅费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5. 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司为研究产品而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出；大规模生产之前，针对产品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等

待期内确认的金额。

（二十一）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承

诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司芯片自研业务及芯片定制化量产业务属于在某一时点履行的履约义务。公司根据与客户签订的合同（订单）约定将相关产品交付客户，经由客户签收或验收确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。涉及境内公司出口销售的，收入在公司完成报关手续并取得出口货物报关单、货运提单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

（二十二）合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十三）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十四）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十六) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁

资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（二十七）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

四、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计税依据	税　率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、8.25%/16.50%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度
本公司	15%	15%	15%
香港晶艺	8.25%/16.50%	8.25%/16.50%	8.25%/16.50%

（二）税收优惠

1. 根据国家西部地区鼓励类产业企业所得税管理的有关办法，本公司 2024 年、2025 年度及 2026 年 1-6 月适用西部地区鼓励类产业企业所得税优惠，按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》财税〔2023〕17 号，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。本公司享受该税收优惠政策。

五、模拟财务报表项目注释

（一）模拟资产负债表项目注释

1. 货币资金

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
银行存款	131,042,197.61	70,809,616.33	201,851,813.94
合　计	131,042,197.61	70,809,616.33	201,851,813.94

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
银行存款	216,582,988.98	158,842,542.27	375,425,531.25
合　计	216,582,988.98	158,842,542.27	375,425,531.25

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
银行存款	101,310,389.36	95,027,574.52	196,337,963.88
合　计	101,310,389.36	95,027,574.52	196,337,963.88

2. 交易性金融资产

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,594,045.24	24,637,078.05	70,231,123.29
其中：结构性存款	45,594,045.24	24,637,078.05	70,231,123.29
合　计	45,594,045.24	24,637,078.05	70,231,123.29

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,171,263.31	55,130,805.18	130,302,068.49
其中：结构性存款	75,171,263.31	55,130,805.18	130,302,068.49
合　计	75,171,263.31	55,130,805.18	130,302,068.49

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,576,552.06	72,765,603.09	150,342,155.15
其中：结构性存款	77,576,552.06	72,765,603.09	150,342,155.15
合　计	77,576,552.06	72,765,603.09	150,342,155.15

3. 应收账款

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	71,463,393.29	44,061,752.38	115,525,145.67
账面余额合计	71,463,393.29	44,061,752.38	115,525,145.67
减：坏账准备	3,573,169.65	2,203,087.62	5,776,257.27
账面价值合计	67,890,223.64	41,858,664.76	109,748,888.40

（续上表）

项　目	2025.12.31

	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	23,771,755.06	32,581,749.83	56,353,504.89
账面余额合计	23,771,755.06	32,581,749.83	56,353,504.89
减：坏账准备	1,188,587.76	1,629,087.51	2,817,675.27
账面价值合计	22,583,167.30	30,952,662.32	53,535,829.62

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	13,899,333.99	32,586,154.41	46,485,488.40
账面余额合计	13,899,333.99	32,586,154.41	46,485,488.40
减：坏账准备	694,966.69	1,629,307.70	2,324,274.39
账面价值合计	13,204,367.30	30,956,846.71	44,161,214.01

4. 预付款项

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	13,921,728.26	289,907.03	14,211,635.29
1-2年			
2-3年	1.25	1,998,579.68	1,998,580.93
3年以上	376.31		376.31
合　计	13,922,105.82	2,288,486.71	16,210,592.53

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	3,231,724.60	742,391.90	3,974,116.50
1-2年	517,047.76	0.16	517,047.92
2-3年		2,062,519.76	2,062,519.76
3年以上	376.31		376.31
合　计	3,749,148.67	2,804,911.82	6,554,060.49

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	4,452,449.60	201,716.25	4,654,165.85
1-2年	24,440.18	2,144,996.79	2,169,436.97
2-3年	376.31		376.31
3年以上			
合　计	4,477,266.09	2,346,713.04	6,823,979.13

5. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
押金保证金	2,727,221.77	495,630.01	3,222,851.78
应收暂付款	446,535.73	60,368.61	506,904.34
账面余额合计	3,173,757.50	555,998.62	3,729,756.12
减：坏账准备	158,687.87	27,799.94	186,487.81
账面价值合计	3,015,069.63	528,198.68	3,543,268.31

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
押金保证金	2,622,203.16	683,714.14	3,305,917.30
应收暂付款	355,481.93	59,509.81	414,991.74
账面余额合计	2,977,685.09	743,223.95	3,720,909.04
减：坏账准备	148,884.27	37,161.21	186,045.48
账面价值合计	2,828,800.82	706,062.74	3,534,863.56

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
押金保证金	2,457,095.57	239,335.52	2,696,431.09

应收暂付款	396,180.09	63,638.96	459,819.05
账面余额合计	2,853,275.66	302,974.48	3,156,250.14
减：坏账准备	142,663.78	15,148.75	157,812.53
账面价值合计	2,710,611.88	287,825.73	2,998,437.61

(2) 账龄情况

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	1,011,926.40	448,290.93	1,460,217.33
1-2年	21,863.89	14,551.65	36,415.54
2-3年	44,892.68	29,878.60	74,771.28
3年以上	2,095,074.53	63,277.44	2,158,351.97
账面余额合计	3,173,757.50	555,998.62	3,729,756.12
减：坏账准备	158,687.87	27,799.94	186,487.81
账面价值合计	3,015,069.63	528,198.68	3,543,268.31

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	819,553.92	533,715.19	1,353,269.11
1-2年	42,828.40	43,763.60	86,592.00
2-3年	1,041,360.07	90,187.89	1,131,547.96
3年以上	1,073,942.70	75,557.27	1,149,499.97
账面余额合计	2,977,685.09	743,223.95	3,720,909.04
减：坏账准备	148,884.27	37,161.21	186,045.48
账面价值合计	2,828,800.82	706,062.74	3,534,863.56

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
1年以内	439,552.27	110,250.56	549,802.83
1-2年	1,054,011.24	107,058.17	1,161,069.41

2-3 年	79,712.15	85,665.75	165,377.90
3 年以上	1,280,000.00		1,280,000.00
账面余额合计	2,853,275.66	302,974.48	3,156,250.14
减：坏账准备	142,663.78	15,148.75	157,812.53
账面价值合计	2,710,611.88	287,825.73	2,998,437.61

6. 存货

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
原材料	48,178,128.52		48,178,128.52
库存商品	39,784,086.69		39,784,086.69
委托加工物资	49,571,179.77		49,571,179.77
周转材料			
发出商品	1,549.63		1,549.63
账面余额合计	137,534,944.61		137,534,944.61
减：跌价准备	20,105,517.57		20,105,517.57
账面价值合计	117,429,427.04		117,429,427.04

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
原材料	32,960,380.97		32,960,380.97
库存商品	56,563,940.36		56,563,940.36
委托加工物资	38,584,742.94		38,584,742.94
周转材料	34,683.19		34,683.19
发出商品			
账面余额合计	128,143,747.46		128,143,747.46
减：跌价准备	18,953,539.28		18,953,539.28
账面价值合计	109,190,208.18		109,190,208.18

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计

原材料	26,393,483.25		26,393,483.25
库存商品	44,908,868.52		44,908,868.52
委托加工物资	46,740,480.46		46,740,480.46
周转材料			
发出商品			
账面余额合计	118,042,832.23		118,042,832.23
减：跌价准备	4,606,975.62		4,606,975.62
账面价值合计	113,435,856.61		113,435,856.61

7. 一年内到期的非流动资产

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
大额存单	21,385,026.66	11,555,556.61	32,940,583.27
账面余额合计	21,385,026.66	11,555,556.61	32,940,583.27
账面价值合计	21,385,026.66	11,555,556.61	32,940,583.27

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
大额存单	18,694,516.58	13,710,608.37	32,405,124.95
账面余额合计	18,694,516.58	13,710,608.37	32,405,124.95
账面价值合计	18,694,516.58	13,710,608.37	32,405,124.95

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
大额存单			
账面余额合计			
账面价值合计			

8. 其他流动资产

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
芯片定制化量产业务存货		107,553,884.35	107,553,884.35
预缴税金		325,608.97	325,608.97
待摊费用	155,048.11	103,193.25	258,241.36
待抵扣进项税额	3,427,381.46	1,852,010.80	5,279,392.26
账面余额合计	3,582,429.57	109,834,697.37	113,417,126.94
减：减值准备		8,746,951.55	8,746,951.55
账面价值合计	3,582,429.57	101,087,745.82	104,670,175.39

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
芯片定制化量产业务存货		60,412,512.50	60,412,512.50
预缴税金		336,026.12	336,026.12
待摊费用			
待抵扣进项税额			
账面余额合计		60,748,538.62	60,748,538.62
减：减值准备		9,440,825.84	9,440,825.84
账面价值合计		51,307,712.78	51,307,712.78

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
芯片定制化量产业务存货		67,157,611.62	67,157,611.62
预缴税金		2,593,624.99	2,593,624.99
待摊费用			
待抵扣进项税额	18,138.26	17,013.40	35,151.66
账面余额合计	18,138.26	69,768,250.01	69,786,388.27
减：减值准备		9,062,553.21	9,062,553.21
账面价值合计	18,138.26	60,705,696.80	60,723,835.06

9. 固定资产

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
账面原值			
机器设备	17,760,845.92	7,425,289.89	25,186,135.81
电子设备	151,604.00	100,901.00	252,505.00
办公设备	264,468.73	176,018.83	440,487.56
期末原值合计	18,176,918.65	7,702,209.72	25,879,128.37
累计折旧			
机器设备	11,677,860.17	3,662,292.70	15,340,152.87
电子设备	127,599.35	84,924.55	212,523.90
办公设备	115,154.34	76,641.70	191,796.04
期末累计折旧合计	11,920,613.86	3,823,858.95	15,744,472.81
账面价值			
机器设备	6,082,985.75	3,762,997.19	9,845,982.94
电子设备	24,004.65	15,976.45	39,981.10
办公设备	149,314.39	99,377.13	248,691.52
期末账面价值合计	6,256,304.79	3,878,350.77	10,134,655.56

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
账面原值			
机器设备	16,753,419.13	6,812,309.36	23,565,728.49
电子设备	106,440.06	108,764.28	215,204.34
办公设备	363,418.54	371,354.08	734,772.62
期末原值合计	17,223,277.73	7,292,427.72	24,515,705.45
累计折旧			
机器设备	9,693,836.55	3,173,331.25	12,867,167.80
电子设备	95,990.87	98,086.92	194,077.79
办公设备	180,867.89	184,817.29	365,685.18

期末累计折旧合计	9,970,695.31	3,456,235.46	13,426,930.77
账面价值			
机器设备	7,059,582.58	3,638,978.11	10,698,560.69
电子设备	10,449.19	10,677.36	21,126.55
办公设备	182,550.65	186,536.79	369,087.44
期末账面价值合计	7,252,582.42	3,836,192.26	11,088,774.68

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
账面原值			
机器设备	15,125,214.02	6,617,342.98	21,742,557.00
电子设备	100,985.34	108,527.81	209,513.15
办公设备	282,437.30	303,532.20	585,969.50
期末原值合计	15,508,636.66	7,029,402.99	22,538,039.65
累计折旧			
机器设备	6,352,512.06	2,137,095.31	8,489,607.37
电子设备	70,078.75	75,312.86	145,391.61
办公设备	77,623.63	83,421.24	161,044.87
期末累计折旧合计	6,500,214.44	2,295,829.41	8,796,043.85
账面价值			
机器设备	8,772,701.96	4,480,247.67	13,252,949.63
电子设备	30,906.59	33,214.95	64,121.54
办公设备	204,813.67	220,110.96	424,924.63
期末账面价值合计	9,008,422.22	4,733,573.58	13,741,995.80

10. 在建工程

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
待安装设备			

账面余额合计			
账面价值合计			

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
待安装设备	97,194.05		97,194.05
账面余额合计	97,194.05		97,194.05
账面价值合计	97,194.05		97,194.05

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
待安装设备			
账面余额合计			
账面价值合计			

11. 使用权资产

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
房屋及建筑物原值	8,271,379.02	5,505,068.39	13,776,447.41
期末原值合计	8,271,379.02	5,505,068.39	13,776,447.41
房屋及建筑物累计折旧	1,724,701.96	1,147,886.25	2,872,588.21
期末累计折旧合计	1,724,701.96	1,147,886.25	2,872,588.21
房屋及建筑物账面价值	6,546,677.06	4,357,182.14	10,903,859.20
期末账面价值合计	6,546,677.06	4,357,182.14	10,903,859.20

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
房屋及建筑物原值	2,775,255.16	2,835,855.15	5,611,110.31
期末原值合计	2,775,255.16	2,835,855.15	5,611,110.31

房屋及建筑物累计折旧	2,390,778.65	2,442,983.28	4,833,761.93
期末累计折旧合计	2,390,778.65	2,442,983.28	4,833,761.93
房屋及建筑物账面价值	384,476.51	392,871.87	777,348.38
期末账面价值合计	384,476.51	392,871.87	777,348.38

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
房屋及建筑物原值	3,016,913.91	3,242,243.58	6,259,157.49
期末原值合计	3,016,913.91	3,242,243.58	6,259,157.49
房屋及建筑物累计折旧	1,528,497.80	1,642,659.47	3,171,157.27
期末累计折旧合计	1,528,497.80	1,642,659.47	3,171,157.27
房屋及建筑物账面价值	1,488,416.11	1,599,584.11	3,088,000.22
期末账面价值合计	1,488,416.11	1,599,584.11	3,088,000.22

12. 无形资产

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
软件使用权原值	2,171,189.11	561,566.77	2,732,755.88
期末原值合计	2,171,189.11	561,566.77	2,732,755.88
软件使用权累计摊销	1,218,471.66	398,669.90	1,617,141.56
期末累计摊销合计	1,218,471.66	398,669.90	1,617,141.56
软件使用权账面价值	952,717.45	162,896.87	1,115,614.32
期末账面价值合计	952,717.45	162,896.87	1,115,614.32

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
软件使用权原值	2,022,506.01	710,249.87	2,732,755.88
期末原值合计	2,022,506.01	710,249.87	2,732,755.88
软件使用权累计摊销	910,667.32	433,198.71	1,343,866.03

期末累计摊销合计	910,667.32	433,198.71	1,343,866.03
软件使用权账面价值	1,111,838.69	277,051.16	1,388,889.85
期末账面价值合计	1,111,838.69	277,051.16	1,388,889.85

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
软件使用权原值	1,983,471.52	705,036.57	2,688,508.09
期末原值合计	1,983,471.52	705,036.57	2,688,508.09
软件使用权累计摊销	499,262.99	298,789.27	798,052.26
期末累计摊销合计	499,262.99	298,789.27	798,052.26
软件使用权账面价值	1,484,208.53	406,247.30	1,890,455.83
期末账面价值合计	1,484,208.53	406,247.30	1,890,455.83

13. 长期待摊费用

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
装修费	41,091.62	27,348.79	68,440.41
其他	303,932.01	40,884.93	344,816.94
合 计	345,023.63	68,233.72	413,257.35

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
装修费	42,313.27	43,237.22	85,550.49
其他	405,242.68	18,584.07	423,826.75
合 计	447,555.95	61,821.29	509,377.24

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
装修费	57,729.45	62,041.20	119,770.65

其他	607,864.00		607,864.00
合 计	665,593.45	62,041.20	727,634.65

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
递延所得税资产	5,667,745.73	1,783,942.54	7,451,688.27
递延所得税负债			

（续上表）

项 目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
递延所得税资产	3,513,164.35	1,642,958.30	5,156,122.65
递延所得税负债			

（续上表）

项 目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
递延所得税资产	2,289,344.89	1,615,812.92	3,905,157.81
递延所得税负债			

15. 其他非流动资产

项 目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
预付长期资产款	1,526,564.03	502,015.97	2,028,580.00
大额存单			
账面余额合计	1,526,564.03	502,015.97	2,028,580.00
账面价值合计	1,526,564.03	502,015.97	2,028,580.00

（续上表）

项 目	2025.12.31

	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
预付长期资产款	856,136.78	871,060.39	1,727,197.17
大额存单			
账面余额合计	856,136.78	871,060.39	1,727,197.17
账面价值合计	856,136.78	871,060.39	1,727,197.17

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
预付长期资产款	607,817.61	129,626.39	737,444.00
大额存单	15,098,810.66	16,226,522.65	31,325,333.31
账面余额合计	15,706,628.27	16,356,149.04	32,062,777.31
账面价值合计	15,706,628.27	16,356,149.04	32,062,777.31

16. 短期借款

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
保证借款	74,974,802.90		74,974,802.90
合 计	74,974,802.90		74,974,802.90

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
保证借款	40,030,222.22		40,030,222.22
合 计	40,030,222.22		40,030,222.22

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
保证借款	41,051,472.22		41,051,472.22
合 计	41,051,472.22		41,051,472.22

17. 应付票据

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
银行承兑汇票	20,802,028.76	8,790,153.85	29,592,182.61
合 计	20,802,028.76	8,790,153.85	29,592,182.61

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
银行承兑汇票	22,178,322.94	6,664,201.20	28,842,524.14
合 计	22,178,322.94	6,664,201.20	28,842,524.14

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
银行承兑汇票			
合 计			

18. 应付账款

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
应付材料及加工费	26,446,194.86	41,963,852.87	68,410,047.73
应付长期资产款	15,600.00	109,750.00	125,350.00
应付费用款	426,419.28	2,100,793.43	2,527,212.71
合 计	26,888,214.14	44,174,396.30	71,062,610.44

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
应付材料及加工费	15,178,603.00	19,772,779.55	34,951,382.55
应付长期资产款	19,975.52		19,975.52
应付费用款	8,188.06		8,188.06
合 计	15,206,766.58	19,772,779.55	34,979,546.13

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
应付材料及加工费	10,390,370.35	15,707,214.39	26,097,584.74
应付长期资产款	94,008.90	139,960.97	233,969.87
应付费用款	212,909.73	21,629.04	234,538.77
合 计	10,697,288.98	15,868,804.40	26,566,093.38

19. 合同负债

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
预收货款	914,816.24		914,816.24
合 计	914,816.24		914,816.24

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
预收货款	1,250,560.53		1,250,560.53
合 计	1,250,560.53		1,250,560.53

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
预收货款	753,184.29		753,184.29
合 计	753,184.29		753,184.29

20. 应付职工薪酬

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
短期薪酬	14,900,465.40	1,643,467.06	16,543,932.46
离职后福利—设定提存计划	12,179.19	1,342.73	13,521.92
合 计	14,912,644.59	1,644,809.79	16,557,454.38

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
短期薪酬	25,844,547.96	4,325,860.46	30,170,408.42
离职后福利—设定提存计划	8,756.10	1,465.82	10,221.92
合 计	25,853,304.06	4,327,326.28	30,180,630.34

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
短期薪酬	18,569,839.93	2,983,171.07	21,553,011.00
离职后福利—设定提存计划	10,228.85	1,643.07	11,871.92
合 计	18,580,068.78	2,984,814.14	21,564,882.92

21. 应交税费

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
增值税			
企业所得税		3,680,409.36	3,680,409.36
城市维护建设税	6,775.43	3,661.16	10,436.59
教育费附加	2,903.76	1,569.07	4,472.83
地方教育附加	1,935.84	1,046.04	2,981.88
印花税	67,291.52	36,361.47	103,652.99
合 计	78,906.55	3,723,047.10	3,801,953.65

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
增值税	1,663,552.68	1,220,053.98	2,883,606.66
企业所得税		4,383,334.91	4,383,334.91
城市维护建设税	142,284.55	104,351.87	246,636.42
教育费附加	60,979.09	44,722.23	105,701.32

地方教育附加	40,652.73	29,814.82	70,467.55
印花税	119,246.31	87,455.56	206,701.87
合 计	2,026,715.36	5,869,733.37	7,896,448.73

（续上表）

项 目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
增值税			
企业所得税			
城市维护建设税	10,741.05	10,074.94	20,815.99
教育费附加	4,603.31	4,317.83	8,921.14
地方教育附加	3,068.87	2,878.56	5,947.43
印花税	89,929.07	84,352.08	174,281.15
合 计	108,342.30	101,623.41	209,965.71

22. 其他应付款

项 目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股权回购款			
预提费用	240,785.13	216,330.90	457,116.03
应付员工款项	138,156.84	91,951.15	230,107.99
合 计	378,941.97	308,282.05	687,224.02

（续上表）

项 目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股权回购款	119,425,275.19	122,033,024.81	241,458,300.00
预提费用	435,525.34	431,465.04	866,990.38
应付员工款项	106,278.70	115,497.38	221,776.08
合 计	119,967,079.23	122,579,987.23	242,547,066.46

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股权回购款			
预提费用	225,357.74	451,912.82	677,270.56
应付员工款项	94,594.08	109,135.35	203,729.43
合 计	319,951.82	561,048.17	880,999.99

23. 一年内到期的非流动负债

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一年内到期的租赁负债	1,237,923.79	823,907.97	2,061,831.76
一年内到期的长期借款	9,757,312.50		9,757,312.50
合 计	10,995,236.29	823,907.97	11,819,144.26

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一年内到期的租赁负债	351,344.02	359,015.90	710,359.92
一年内到期的长期借款	10,008,250.00		10,008,250.00
合 计	10,359,594.02	359,015.90	10,718,609.92

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一年内到期的租赁负债	1,138,847.10	1,223,906.21	2,362,753.31
一年内到期的长期借款			
合 计	1,138,847.10	1,223,906.21	2,362,753.31

24. 其他流动负债

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计

待转销项税额	105,076.27		105,076.27
合 计	105,076.27		105,076.27

（续上表）

项 目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
待转销项税额	148,279.93		148,279.93
合 计	148,279.93		148,279.93

（续上表）

项 目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
待转销项税额	97,913.97		97,913.97
合 计	97,913.97		97,913.97

25. 租赁负债

项 目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
房屋及建筑物	5,161,391.98	3,435,196.93	8,596,588.91
合 计	5,161,391.98	3,435,196.93	8,596,588.91

（续上表）

项 目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
房屋及建筑物			
合 计			

（续上表）

项 目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
房屋及建筑物	277,729.82	298,473.12	576,202.94
合 计	277,729.82	298,473.12	576,202.94

26. 递延收益

项　目	2026.6.30		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
政府补助	1,481,976.75		1,481,976.75
合 计	1,481,976.75		1,481,976.75

（续上表）

项　目	2025.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
政府补助	3,333,444.71		3,333,444.71
合 计	3,333,444.71		3,333,444.71

（续上表）

项　目	2024.12.31		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
政府补助	220,111.39		220,111.39
合 计	220,111.39		220,111.39

（二）模拟利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项　目	2026 年 1-6 月					
	芯片自研业务		芯片定制化量产业务		合计	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,104,701.96	122,234,608.68	97,304,691.35		277,409,393.31	122,234,608.68
其他业务						
合 计	180,104,701.96	122,234,608.68	97,304,691.35		277,409,393.31	122,234,608.68

（续上表）

项　目	2025 年度					
	芯片自研业务		芯片定制化量产业务		合计	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	201,531,489.52	131,044,331.76	147,961,792.24		349,493,281.76	131,044,331.76
其他业务	223,491.00				223,491.00	

合 计	201,754,980.52	131,044,331.76	147,961,792.24		349,716,772.76	131,044,331.76

（续上表）

项 目	2024 年度					
	芯片自研业务		芯片定制化量产业务		合计	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,540,344.47	86,998,567.30	123,397,822.03		254,938,166.50	86,998,567.30
其他业务						
合 计	131,540,344.47	86,998,567.30	123,397,822.03		254,938,166.50	86,998,567.30

2. 税金及附加

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
城市维护建设税	346,601.03	187,288.42	533,889.45
教育费附加	148,543.31	80,266.47	228,809.78
地方教育附加	99,028.86	53,510.98	152,539.84
印花税	121,446.19	65,624.33	187,070.52
合 计	715,619.39	386,690.20	1,102,309.59

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
城市维护建设税	549,194.58	402,780.77	951,975.35
教育费附加	235,369.10	172,620.33	407,989.43
地方教育附加	156,912.74	115,080.22	271,992.96
印花税	213,394.36	156,503.99	369,898.35
合 计	1,154,870.78	846,985.31	2,001,856.09

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
城市维护建设税	84,629.26	79,380.94	164,010.20

教育费附加	36,269.69	34,020.40	70,290.09
地方教育附加	24,179.79	22,680.27	46,860.06
印花税	166,894.24	156,544.21	323,438.45
合 计	311,972.98	292,625.82	604,598.80

3. 销售费用

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用	7,859,938.95	355,738.85	8,215,677.80
职工薪酬	7,506,500.16	339,742.30	7,846,242.46
差旅费	609,292.57	27,576.43	636,869.00
折旧摊销	336,642.55	15,236.36	351,878.91
检测费	398,785.02	18,048.91	416,833.93
业务招待费	72,129.28	3,264.55	75,393.83
样品费	165,450.49	7,488.25	172,938.74
其他	285,195.62	12,907.87	298,103.49
合 计	17,233,934.64	780,003.52	18,013,938.16

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用			
职工薪酬	14,250,831.95	2,086,244.69	16,337,076.64
差旅费	1,126,722.14	164,946.03	1,291,668.17
折旧摊销	624,187.74	91,377.71	715,565.45
检测费	410,855.21	60,146.98	471,002.19
业务招待费	170,087.56	24,899.90	194,987.46
样品费	97,963.63	14,341.34	112,304.97
其他	372,619.50	54,549.47	427,168.97
合 计	17,053,267.73	2,496,506.12	19,549,773.85

（续上表）

项　目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用			
职工薪酬	12,551,394.33	2,090,922.90	14,642,317.23
差旅费	869,301.07	144,815.90	1,014,116.97
折旧摊销	577,467.10	96,199.61	673,666.71
检测费	735,604.09	122,543.47	858,147.56
业务招待费	201,718.55	33,604.07	235,322.62
样品费	73,856.11	12,303.61	86,159.72
其他	450,094.34	74,980.72	525,075.06
合 计	15,459,435.59	2,575,370.28	18,034,805.87

4. 管理费用

项　目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用	108,553,638.76	44,367,234.72	152,920,873.48
职工薪酬	13,000,061.95	1,640,168.21	14,640,230.16
咨询服务费	1,149,033.74	52,004.98	1,201,038.72
折旧摊销费	912,257.37	41,288.54	953,545.91
差旅费	629,229.16	28,478.75	657,707.91
其他	1,512,791.12	68,468.54	1,581,259.66
合 计	125,757,012.10	46,197,643.74	171,954,655.84

（续上表）

项　目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用	52,633,131.75	38,596,144.25	91,229,276.00
职工薪酬	19,979,069.03	4,762,413.28	24,741,482.31
咨询服务费	2,171,269.77	317,862.15	2,489,131.92
折旧摊销费	889,938.28	130,282.15	1,020,220.43

差旅费	790,110.09	115,667.84	905,777.93
其他	1,300,393.47	190,370.57	1,490,764.04
合 计	77,763,912.39	44,112,740.24	121,876,652.63

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用			
职工薪酬	13,974,077.49	3,897,409.70	17,871,487.19
咨询服务费	1,223,855.72	203,880.77	1,427,736.49
折旧摊销费	730,845.20	121,750.69	852,595.89
差旅费	782,134.73	130,294.96	912,429.69
其他	2,054,841.05	342,313.70	2,397,154.75
合 计	18,765,754.19	4,695,649.82	23,461,404.01

5. 研发费用

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用	5,020,462.31	636,396.63	5,656,858.94
职工薪酬	17,533,232.16	2,222,522.39	19,755,754.55
模具费	3,345,334.15		3,345,334.15
折旧摊销	2,393,682.37	303,424.53	2,697,106.90
材料费	1,072,315.91	135,927.37	1,208,243.28
其他	1,800,688.70	228,256.31	2,028,945.01
合 计	31,165,715.60	3,526,527.23	34,692,242.83

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用	18,295,069.00		18,295,069.00
职工薪酬	37,434,366.68	4,674,032.29	42,108,398.97

模具费	10,426,890.29		10,426,890.29
折旧摊销	4,854,099.51	606,079.92	5,460,179.43
材料费	3,575,503.54	446,435.20	4,021,938.74
其他	3,743,361.81	467,393.87	4,210,755.68
合 计	78,329,290.83	6,193,941.28	84,523,232.11

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
股份支付费用	17,432,689.10		17,432,689.10
职工薪酬	36,291,226.25	4,158,201.14	40,449,427.39
模具费	17,777,077.02		17,777,077.02
折旧摊销	4,256,521.93	487,706.70	4,744,228.63
材料费	3,832,414.26	439,113.00	4,271,527.26
其他	3,379,520.86	387,221.07	3,766,741.93
合 计	82,969,449.42	5,472,241.91	88,441,691.33

6. 财务费用

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
利息支出	975,251.52	44,024.71	1,019,276.23
利息收入	-882,743.49	-476,996.94	-1,359,740.43
汇兑损益	255,201.13	137,899.81	393,100.94
手续费	43,031.92	23,252.62	66,284.54
合 计	390,741.08	-271,819.80	118,921.28

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
利息支出	1,370,134.08	29,980.40	1,400,114.48
利息收入	-1,951,197.39	-1,431,013.38	-3,382,210.77

汇兑损益	313,627.02	230,014.89	543,641.91
手续费	69,759.26	51,161.63	120,920.89
合 计	-197,677.03	-1,119,856.46	-1,317,533.49

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
利息支出	1,080,538.52	72,637.88	1,153,176.40
利息收入	-1,721,648.82	-1,614,879.90	-3,336,528.72
汇兑损益	-228,966.71	-214,767.23	-443,733.94
手续费	42,188.89	39,572.53	81,761.42
合 计	-827,888.12	-1,717,436.72	-2,545,324.84

7. 其他收益

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
与收益相关的政府补助	1,896,755.88		1,896,755.88
与资产相关的政府补助	23,333.34		23,333.34
增值税加计抵减	1,600,542.27	864,864.80	2,465,407.07
代扣个人所得税手续费返还	26,104.39	2,877.95	28,982.34
重点人群增值税减免			
合 计	3,546,735.88	867,742.75	4,414,478.63

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
与收益相关的政府补助	4,393,712.94		4,393,712.94
与资产相关的政府补助	46,666.68		46,666.68
增值税加计抵减	4,717,879.98	3,460,105.77	8,177,985.75
代扣个人所得税手续费返还	18,462.21	3,090.68	21,552.89
重点人群增值税减免	29,941.11	21,958.89	51,900.00

合 计	9,206,662.92	3,485,155.34	12,691,818.26

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
与收益相关的政府补助	9,729,667.28		9,729,667.28
与资产相关的政府补助	19,888.61		19,888.61
增值税加计抵减	3,097,184.55	2,905,111.08	6,002,295.63
代扣个人所得税手续费返还	5,751.34	923.84	6,675.18
重点人群增值税减免			
合 计	12,852,491.78	2,906,034.92	15,758,526.70

8. 投资收益

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
处置交易性金融资产取得的投资收益			
合 计			

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
处置交易性金融资产取得的投资收益	33,624.02	24,659.94	58,283.96
合 计	33,624.02	24,659.94	58,283.96

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
处置交易性金融资产取得的投资收益	-123,703.35	-116,031.82	-239,735.17
合 计	-123,703.35	-116,031.82	-239,735.17

9. 公允价值变动收益

项　目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
交易性金融资产	351,164.17	189,754.15	540,918.32
合 计	351,164.17	189,754.15	540,918.32

（续上表）

项　目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
交易性金融资产	1,793,907.56	1,315,656.59	3,109,564.15
合 计	1,793,907.56	1,315,656.59	3,109,564.15

（续上表）

项　目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
交易性金融资产	2,182,628.28	2,047,271.48	4,229,899.76
合 计	2,182,628.28	2,047,271.48	4,229,899.76

10. 信用减值损失

项　目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
坏账损失	-2,394,385.49	-570,738.56	-2,965,124.05
合 计	-2,394,385.49	-570,738.56	-2,965,124.05

（续上表）

项　目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
坏账损失	-499,841.56	-25,818.79	-525,660.35
合 计	-499,841.56	-25,818.79	-525,660.35

（续上表）

项　目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
坏账损失	-432,404.56	-955,824.31	-1,388,228.87

合 计	-432,404.56	-955,824.31	-1,388,228.87

11. 资产减值损失

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
存货跌价损失	-3,810,606.53		-3,810,606.53
其他流动资产减值损失		140,332.45	140,332.45
合 计	-3,810,606.53	140,332.45	-3,670,274.08

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
存货跌价损失	-20,998,143.91		-20,998,143.91
其他流动资产减值损失		-1,317,310.50	-1,317,310.50
合 计	-20,998,143.91	-1,317,310.50	-22,315,454.41

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
存货跌价损失	-5,509,443.92		-5,509,443.92
其他流动资产减值损失		-4,661,216.85	-4,661,216.85
合 计	-5,509,443.92	-4,661,216.85	-10,170,660.77

12. 资产处置收益

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
使用权资产处置收益			
合 计			

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计

使用权资产处置收益	-12,612.45	-12,887.85	-25,500.30
合 计	-12,612.45	-12,887.85	-25,500.30

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
使用权资产处置收益	62,735.30	67,420.92	130,156.22
合 计	62,735.30	67,420.92	130,156.22

13. 营业外收入

项 目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
非流动资产毁损报废利得			
违约金			
其他			
合 计			

（续上表）

项 目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
非流动资产毁损报废利得			
违约金			
其他	0.18		0.18
合 计	0.18		0.18

（续上表）

项 目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
非流动资产毁损报废利得	336.28		336.28
违约金	32,000.00		32,000.00
其他	0.07		0.07
合 计	32,336.35		32,336.35

14. 营业外支出

项　目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
对外捐赠	8,985.87		8,985.87
违约赔偿			
罚款支出			
其他			
合 计	8,985.87		8,985.87

（续上表）

项　目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
违约赔偿	12,604.00		12,604.00
罚款支出			
其他	29.16		29.16
合 计	12,633.16		12,633.16

（续上表）

项　目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
违约赔偿			
罚款支出	1,303.76		1,303.76
其他			
合 计	1,303.76		1,303.76

15. 所得税费用

项　目	2026 年 1-6 月		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
当期所得税费用		10,684,103.82	10,684,103.82
递延所得税费用	-2,154,581.38	-141,990.69	-2,296,572.07
合 计	-2,154,581.38	10,542,113.13	8,387,531.75

（续上表）

项　目	2025 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
当期所得税费用		6,116,814.46	6,116,814.46
递延所得税费用	-1,223,819.46	-31,210.32	-1,255,029.78
合 计	-1,223,819.46	6,085,604.14	4,861,784.68

（续上表）

项　目	2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
当期所得税费用		119,836.19	119,836.19
递延所得税费用	-643,320.21	-441,008.49	-1,084,328.70
合 计	-643,320.21	-321,172.30	-964,492.51

晶艺半导体有限公司

二〇二六年十一月十二日



统一社会信用代码
91330000579342121 3（1/3）

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　钟建国

经营范围　许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出　资　额　壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期　2011 年 07 月 18 日

主要经营场所　浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

登记机关　杭州市西湖区市场监督管理局

2026 年 02 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供晶艺半导体有限公司天健审〔2026〕18230 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

3-1-2-67



会计师事务所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制

证书序号：0019886

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：浙江省财政厅

2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供晶艺半导体有限公司天健审〔2026〕18230 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000596493826	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101082726007 2	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	91370100061188932 3	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	913101015680937 64U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	913101060862422 61L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000850462 85W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108308966493 76	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91610136073401 69X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供晶艺半导体有限公司天健审〔2026〕18230号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）
330102100597O9

本复印件仅供晶艺半导体有限公司天健审〔2026〕18230 号报告后附之用，证明 夏均军 是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供晶艺半导体有限公司天健审〔2026〕18230 号报后附之用，证明 翁淑丹 是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。